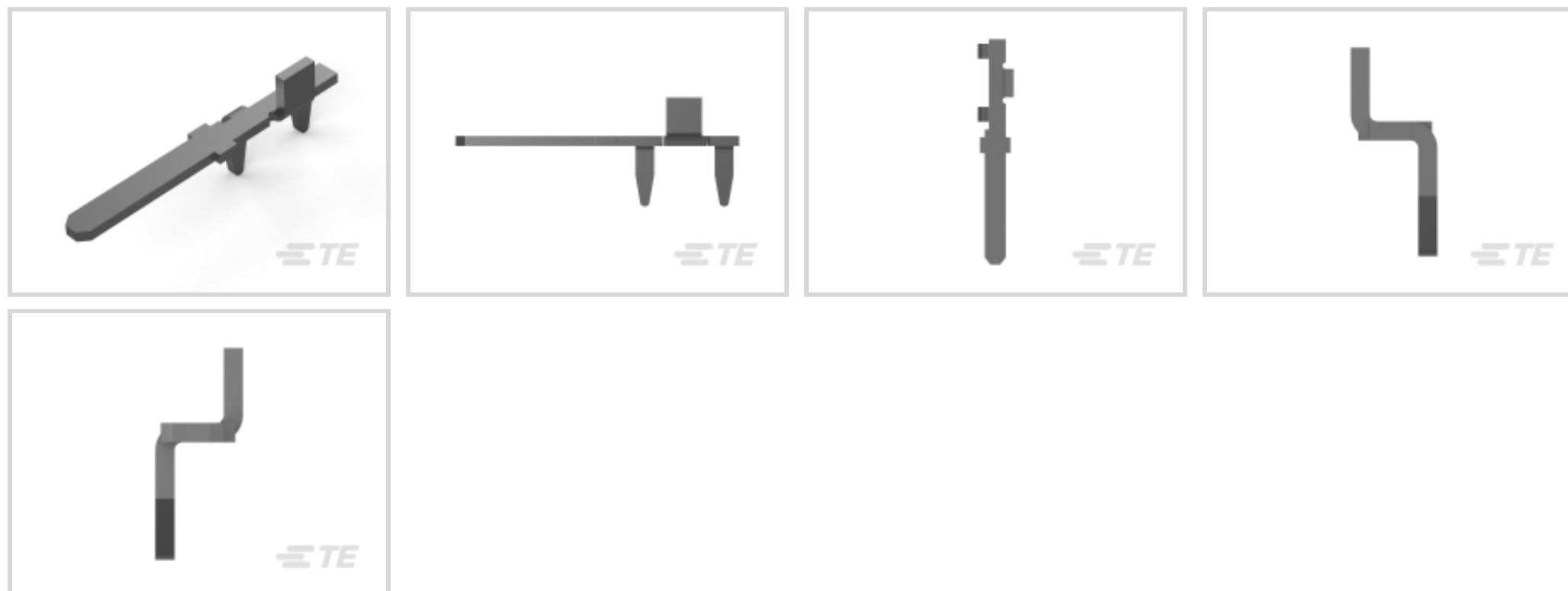


TE 内部编号 1217183-1

PCB Terminals, Tab, Mating Tab Width .067 in [1.7 mm], Through Hole - Solder, Tin Plating, Brass, Reel, Terminates To Printed Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端

PCB 厚度 (建议) : 1.57 – 2.36 mm [.062 – .093 in]

对接公端宽度: 1.7 mm [.067 in]

对接公端厚度: .64 mm [.025 in]

PCB 的外形高度: 4.34 mm [.173 in]

产品特性

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm [100 – 200 μin]
端子底板材料厚度	2.54 μm [100 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm [100 – 200 μin]
PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	1.7 mm[.067 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
端子电镀材料	锡
端子底板材料	黄铜
端子方向	直角

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	印刷电路板

尺寸

板下延伸	3.86 mm[.152 in]
------	------------------



端子材料厚度	.64 mm[.025 in]
PCB 厚度 (建议)	1.57 – 2.36 mm[.062 – .093 in]
PCB 的外形高度	4.34 mm[.173 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	4000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

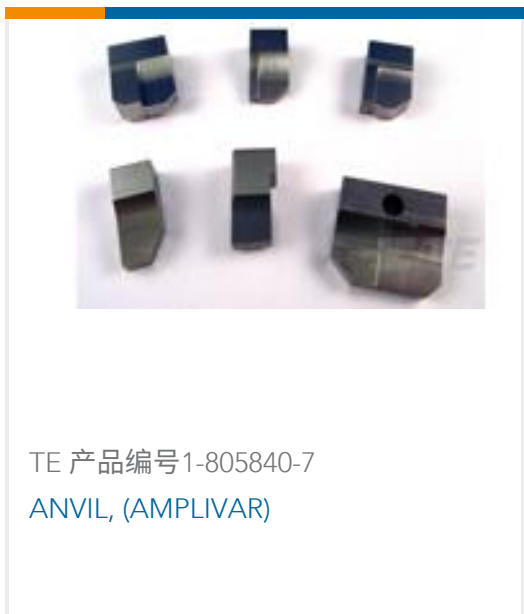
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档



产品图纸

[FASTON,SPECIAL FLAG,TAB,TNBR](#)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217183-1_H_c-1217183-1-h.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217183-1_H_c-1217183-1-h.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217183-1_H_c-1217183-1-h.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。